

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

深圳市兆驰股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-006

投资者关系 活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div>
参与单位 名称	瑞民基金、浙商证券、鼎熙基金、深圳赛博纳资本、广州金诚华毅资本、深圳左岸绿洲投资、中信证券、东北证券、深圳优美利投资、深圳诺信达、广东国建安证券基金、广州基金业协会、广州泽恩投资、国盛投资、厦门市政府驻深圳经济处、星斗资本、华福证券、中金资本、亚太汇金基金、国投证券、紫筹投资、民沣资产、大秦基金、莫熊有（个人投资者）、广州欧锋科技、深圳协众投资、信和明投资、合心基金、丰坤投资、紫薇基金
时间	2025 年 12 月 3 日—12 月 5 日
地点	公司会议室
上市公司 接待人员 姓名	副总经理兼董事会秘书：单华锦女士
投资者关系 活动主要内 容介绍	<div>一、介绍行业及公司近况；</div> <div>二、交流内容：<div>（一）公司光模块业务的发展路径是怎样的？未来是否会与海外大厂合作，切入光模块高端市场？ 公司光模块业务以“终端带动模块、模块验证芯片”为战略路径，依托智能多媒体视听产品终端所构建的真实应用场景，持续对自研光模</div></div>

块与光芯片的可靠性进行验证，目标是逐步实现关键部件的自主可控。目前，公司在 200G 及以下低速光模块领域，已实现稳定量产并具备良好经济效益；400G/800G 高速光模块样品已进入国内头部客户送样测试阶段，预计 2025 年第二季度可实现小批量出货。在海外拓展方面，公司基于与知名国际客户在终端领域的长期合作基础，未来在切入海外光模块市场时，可能会考虑采用“终端验证+高端代工”的双轨模式，并以终端实测作为产品放量的前提。整体上，公司光模块业务将遵循“先内部替代、再高端代工、最终出海”的渐进路径，稳步提升在全球市场的竞争力。

（二）公司近期拟投资建设 PCB 产线，是否已经开始建设？逻辑是什么？是否属于跨界扩张？

2025 年下半年，公司已启动 PCB 印制电路板生产线投资建设工作。这一决策的核心逻辑在于，PCB 产线建设是公司践行全链条协同战略的核心举措，该战略旨在巩固技术整合优势、强化供应链自主可控能力。通过自建产线，公司可进一步提升产业链各环节的协同性，提高产品一致性、缩短研发周期，加速光模块与高端显示产品量产进程。该布局不仅增强了公司在光通信及 Mini/Micro LED 领域的生产管控与工艺技术实力，为新兴业务扩张提供可靠配套支撑；更重要的是，作为产业链关键配套环节，自建 PCB 产线有助力核心产品性能与良率提升，进而全面增强公司在光模块及高端显示领域综合竞争力。因此，PCB 产线建设是公司基于自身核心业务和产业链布局进行的战略性投入。

（三）市场普遍认为 200G 及以下低速光模块技术门槛低、毛利率不高，多家同行明确表示不愿投入资源，请问兆驰股份为何仍将低速模块作为重要战略方向？

200G 及以下低速光模块具备需求刚性强、订单稳定性高、规模效应显著等核心特征，可为公司高速模块产线提供稳定产能支撑，有效摊薄固定成本。依托产业链垂直整合策略，公司已实现从芯片流片到模块

验证的全流程有序推进，充分彰显高价值环节技术积累，为后续规模化量产筑牢基础。

未来，公司将持续深耕低速光模块领域，致力于在国内市场稳固并扩大份额，通过构建“以低速支撑高速” 的良性发展格局，进而强力驱动 400G/800G 等高端光模块产品的快速市场渗透与盈利目标的实现。

（四）请问公司光芯片业务的建设进展、与光模块的协同情况如何？

公司光芯片业务正在从起步阶段迈向产业化落地与产业链协同发展。目前公司 25G DFB 激光器芯片已具备量产能力，2.5G DFB 激光器芯片已成功通过客户验证并处于小批量出货阶段。光芯片技术与公司现有 LED 技术同源，通过技术复用与工艺协同可以显著提升研发效率及量产稳定性，为公司光通信业务的高质量发展夯实基础；“芯片-器件-模块”垂直一体化布局的持续完善，有效强化供应链自主性并增强产品核心竞争力。未来，公司将持续推进更高速率 DFB 芯片研发并计划于 2026 年实现产品落地，同时积极布局 Micro LED 光互连等前沿技术领域，持续巩固在高速光通信领域的技术壁垒与产业协同优势。

（五）公司 LED 产业链业务核心竞争力是什么？具体体现在哪些关键方面？

公司在 LED 产业的核心竞争力，主要得益于"芯片-封装-显示"上下游深度垂直一体化布局的协同赋能与持续的技术创新。公司构建全链条闭环生态，实现供应链自主可控，成本优化与市场快速响应，同时公司研发端不断突破芯片微缩、巨量转移、前沿封装等关键技术，为 Mini/Micro LED 产业化奠定基础。凭借产业链与技术双重优势，公司稳居全球 LED 市场核心地位，2025 年第三季度，LED 业务净利润占比超 60%，Mini RGB 芯片全球市占率超 50%，Mini/Micro LED 产品出货量占行业半数以上，同时产业链各环节均已成功导入头部知名国际客

	<p>户。未来，公司将持续以创新推动业务发展，聚焦更多高附加值应用领域，推动战略升级，持续提升行业优势地位。</p> <p>（六）公司应收账款规模较大，主要原因是什么？是否存在回款风险？</p> <p>公司应收账款主要来源于海外零售渠道客户及其子品牌客户，结算周期符合行业常规。该类客户与公司合作已逾十年，履约情况持续良好，历史坏账率维持在较低水平。同时，公司购买出口信用保险，降低有效管控相关汇率与信用风险。2024 年应收账款规模上升，主要系海外业务持续放量、LED 产品逐步贡献收入所致。预计随着 LED 等业务在国内终端客户中进一步起量，公司应收账款结构将趋于优化，账期压力有望得到缓解。</p>
附件清单 （如有）	
日期	2025 年 12 月 3 日—12 月 5 日